Intelligente Schleifprozesse für Saphir Wafer

Motivation

Bei der hochgenauen Schleifbearbeitung bestimmen die Eigenschaften des Werkzeuges Form, Rauheit und Schädigungstiefe sowie die Produktivität. Eine gute Beschreibung der Werkzeugeigenschaften erhöht die Wirtschaftlichkeit von Prozessplanung und Prozess selbst.

Vorgehen

Durch das Projekt sollten Erkenntisse über die Charakterisierung und die Abtragseingenschaften der Schleifwerkzeuge gewonnen werden. Das Projektziel ist damit die Entwicklung neuer, angepasster Schleifwerkzeuge auf Basis der Abhängigkeiten von Werkzeugeingenschaften und Abtragsmechansimen.

Eckdaten

Kurztitel

OPUS

Laufzeit

01.03.2015 - 31.08.2017

Fördergeber

Bundesministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Projektträger

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen

Projektleitung

Prof. Dr.-Ing. Rolf Rascher